发布单位 ： 円星科技股份有限公司
发布日期 ： 2026/11/6

円星科技 (M31)2026 年第三季在线法人说明会 Q&A 完整实录

主讲人：总经理 张原熏

Q1：请总经理说明 2026 年第四季的营运重点与主要成长动能。目前 EPS 仍为负数，是否能预测全年 EPS 范围与支撑？是否调整本年度营收成长幅度？以及今年费用增幅是否会控制在 10% 以下？

答： 前三季累计 EPS 虽仍为负数，但公司营运在第四季通常会有较佳的发展与展现。目前目标与责任就是希望在第四季实现「倒吃甘蔗」，顺利达成设定的营收目标。对今年全年 EPS 转为正数抱持信心，团队正全力朝此方向推进。
在新制程项目方面，随着业务重心更聚焦于先进制程，客户对各项目决策的时间确实拉得较长。但在北美晶圆厂、Fabless 客户以及全球生态系伙伴的合作带动下，预期今年全年营收仍能比去年成长，并务必达成全年 EPS 转正的目标，同时延续动能至明年，让权利金如期展开，成为营运回升的转折点。

Q2：第三季实现单季转亏为盈后，第四季能否延续获利？本次转盈是一次性的表现，还是 M31 真正的营运转折？

答： 过去在先进技术上的研发投入已开始看到成果，后续关键在于权利金的累积是否能成为公司长远成长的基石。若要达成全年 EPS 转正的目标，第四季势必需要延续单季获利的表现。随着先进制程权利金规划于明年逐步发挥效益，将为营运奠定良好基础。目前已具备营运转折的契机，期望自明年起能够展现更稳健的营运成绩。

Q3：请总经理说明 2027 年及 2028 年的营运展望（包含营收成长、营业利益率、费用控制规划以及获利能力发展方向）。

答： 过去长期布局的先进制程权利金，预计在 2027 年与 2028 年迎来显著的收成期。目前正密切追踪 2 奈米、3 奈米及 4 奈米/5 奈米项目客户迈入量产的进度，整体看法乐观，预期 2027 至 2028 年营运成果将逐步攀升。
在研发费用与人力控管方面，过去两年因 EDA 工具授权及人员扩充导致费用增幅较大，今年起已开始实施控制。目标是将每年的费用增幅控制在约 10%（或略高于 10%）的水平，同时将全球总人数维持在大约 400 人的规模。随着营收规模成长与费用有效控管，营业利益率将可望逐步拉升。

Q4：请分享对公司整体授权金与权利金成长的看法、预估成长幅度与营收占比，以及 2027 年成长动能来自哪些制程节点？上下半年营收节奏如何分布？

答： 展望未来营收结构，目标是授权金维持约 10% 的年成长率，而权利金部分则期望挑战 30% 以上的显著成长，以带动更健全的营收结构与获利质量。
在制程节点方面，成长动能将全面集中于 16 奈米以下的先进制程与泛先进制程。公司亦将持续透过导入 AI 技术来提高研发产出效率与减少出错率，藉此优化营业利益率。
在上下半年营收分布方面，预计仍会呈现下半年高于上半年的趋势，但目标是让节奏更加平衡健康，朝上下半年 45:55 的营收比重迈进。

Q5：2 奈米相关项目进展如何？目前在台积电 N2/GAA 平台的客户导入和开案情况是否符合预期？

答： 2 奈米属于半导体金字塔顶端的制程，市场上有能力采用该制程的客户数量相对有限。但好消息是公司的领导客户已持续采用 2 奈米甚至更先进的 A14 平台进行开案，且在台积电之外的其他晶圆厂亦有 2 奈米相关斩获。
针对极先进制程（2nm 及以下），公司的开案模式与以往「先开发大量 IP 再等客户采用」不同，而是改采与领导客户前瞻共研/前期合作（Engage/Co-development）的模式。依据客户实际需求与验证节奏共同开发，能精准控管开发费用，避免盲目投入大量 IP 研发资源。

Q6：先前法说会提到北美 2 奈米 IC 设计大厂项目预计于今年底至明年初开始贡献权利金，目前进度是否符合预期？

答： 实际时程仍需视客户进入量产的具体节奏而定。目前已知客户已积极准备进入量产阶段，非常期待最快于 明年初（2027 Q1） 开始看见该项目的权利金贡献。

Q7：考虑目前有多个 2nm、3nm 及 A14 项目推进，2027 年是否为先进制程权利金迈向收成期的重要转折点？对营业利益率的改善幅度为何？

答： 若先进制程项目如预期推进并随客户量产持续累积，2027 年确实会是权利金显著进帐并迈入收成期的重要转折点。随着高毛利的权利金营收占比拉高，将会对公司的营业利益率带来非常显著且正面的改善效益。

Q8：随着 AI 推论与客制化芯片需求增加，M31 在 AI 时代的商机为何？近期是否有 AI 伙伴或产品开发？AI 营收占比大概是多少？

答： 目前公司所有新导入与洽谈中的客户项目，事实上均与 AI 应用密切相关，AI 已深入至各类芯片设计中。即使是在成熟制程（例如 22nm），客户亦会在芯片中导入小型语言模型并对低功耗提出强烈需求。
特别是在人形机器人与智能终端装置（Smart Connectivity）领域，对低功耗与高速传输 IP 的需求显著增加，AI 将会是推动公司未来营收成长的核心驱动力。

Q9：市场传出有同业取得数千万美元规模的 2 奈米 AI 项目，公司是否有参与相关商机？在争取 2 奈米大型项目时面临哪些挑战？未来是否能争取大型 IC 设计公司的案件？

答： 纯 IP 授权与 ASIC（客制化芯片）的商业模式与收费结构有所不同，IP 具备高度重复利用与长期发酵的特性。
随着芯片进入 2 奈米以下极先进制程，开案规模庞大且高度依赖先进封装，客户大多为大型 IC 设计公司。M31 除了持续稳固中小型客户（蚂蚁雄兵）基础外，也已成功切入大型行动芯片与高阶网通大厂的先进制程合作。在台积电 OIP 上，Broadcom 曾分享如何从 Follower 转变为 Early Adopter，这也是 M31 努力的方向。公司将持续深化与晶圆厂及大型客户的合作，提供高稳定性的 IP 解决方案。

Q10：请总经理分享 6 奈米及更先进制程的接案状况、产品应用与客户地区性质，以及光通讯或 AI 服务器项目的最新进展？

答： 在 6 奈米及更先进制程平台方面，市场需求非常强劲，广泛应用于高速储存、边缘 AI 及人形机器人相关芯片。
在光通讯与 AI 服务器领域，公司正积极布局点对点 SerDes（如 PCIe 6.0 64G、112G） 连接技术与光讯模块 IP，并关注 CPO（共同封装光学）中的 OCI（Optical Circuit Interface） 技术。此外，由于 AI 服务器与高效能运算芯片对 SRAM 的需求极大，公司正强化客制化 SRAM 的开发能力，以满足市场对高传输与客制化内存的庞大需求。